

電子材料研究会

〔委員長〕奥村次徳（都立大）

〔幹事〕岡田至崇（筑波大），羽路伸夫（横浜国大）

日時 7月4日（金）10：00～17：00

場所 東京大学山上会館（東京都文京区本郷7-3-1，地下鉄丸の内線 本郷三丁目駅より徒歩8分，
Tel 03-3818-3008）

協賛 ULSIインターコネクト材料技術調査専門委員会（委員長 財満鎮明，幹事 大場隆之，
山本直樹，幹事補佐 酒井 朗）

議題 テーマ「超高速配線技術：新材料・新プロセス」

EFM-03-19 超高速配線技術の現状と課題

小川真一（Selete）

EFM-03-20 低誘電率層間絶縁膜材料の機械的強度特性評価

清野 豊，市川理恵，吉川公磨（MIRAI-ASRC，広島大）

EFM-03-21 Low-k膜のEBキュアにおけるmodule開発

中田錬平（東芝セミコンダクター社）

EFM-03-22 ポーラスlow-k/Cu配線プロセス対応の低圧CMP技術

近藤誠一（Selete）

EFM-03-23 超臨界流体中でのCu薄膜堆積

近藤英一（山梨大）

EFM-03-24 感光性樹脂とパルスめっき法を用いた5 μ m厚めっきCuによる多層配線技術

菊池 克，高宮 真，工藤義治，副島康志（NEC実装研）

EFM-03-25 バリヤメタルとCu用メタルバリヤ

霜垣幸浩（東大）

EFM-03-26 Cu配線の無電解置換めっきによる形成

新宮原正三（広島大）

EFM-03-27 カーボンナノチューブの配線・電極への応用

栗野祐二（富士通研）

発表は1件35分（質疑5分含）です。